

アルミベースBu基板 R&D

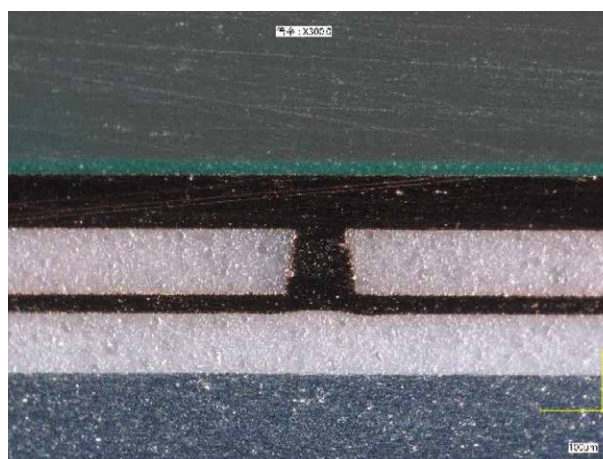
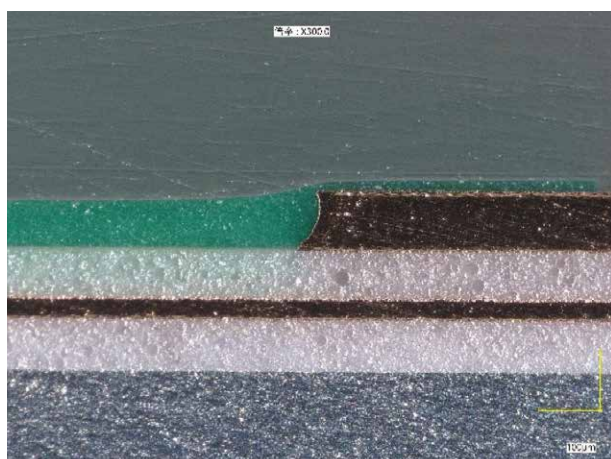
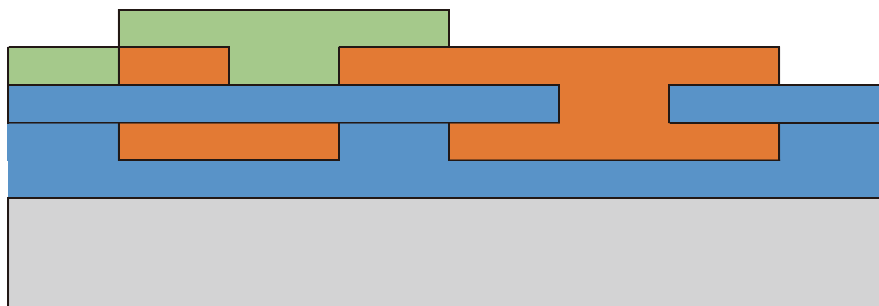
Aluminum Base Bu IMS

特長 Features

アルミベース基板で全層放熱樹脂を使用したビルドアップ構造

- ガラスクロス不使用 全層放熱樹脂による高放熱構造
- 同一材料の使用による低そり/低歪み
- レーザービアのため穴数増に伴う許容電流量/熱パス量の増大
- 表面導体の平坦性確保による実装性向上

構造イメージ



使用材料	H5T (熱伝導率: 5W/m・K)
材料厚み	100μm
LVH径	開口110μm
めっき	フィールドめっき仕様